

# 03

## 主席報告書

本人謹代表董事會（「董事會」）欣然提呈福邦控股有限公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零五年十二月三十一日止年度之全年業績。

### 財務業績

年內，本集團錄得營業額22,485,000美元（二零零四年：24,532,000美元）。毛利由去年之1,040,000美元增至1,605,000美元。營業額下跌是由於一家附屬公司遷址所致，而毛利大幅增加則主要歸因於歐洲及中東市場之出口銷售額增加所致。本集團錄得淨虧損5,068,000美元（二零零四年：2,995,000美元），原因為攤佔聯營公司業績減少及遞延稅項開支增加。每股基本虧損為0.06美仙（二零零四年：0.03美仙）。

### 股息

董事會不建議就截至二零零五年十二月三十一日止年度派付末期股息（二零零四年：無）。

### 業務回顧

#### 木材業務

二零零五年對本集團木材業務而言是充滿考驗的一年。原材料價格，包括原木及化學品之價格，持續高企。此外，業內競爭仍然激烈，構成訂價壓力。儘管本集團因鄰近原材料來源而在控制成本方面享有優勢，並已調整產品組合，惟營商環境仍然困難。因此，本集團主要木材相關產品（包括木芯板、刨花板及門皮）之經營業績均受影響。

本集團擁有67%權益之附屬公司吉林福敦木業有限公司（「福敦」）為中國生產模製門皮之專家，其產品主要出口土耳其、中東及巴基斯坦等海外市場。年內，本集團優質模製門皮之銷售額增加超過四倍，並享有較高之毛利率。

於回顧年度內，本集團完成搬遷瀋陽福昇中密度板有限公司（「福昇」，本集團擁有51%權益之附屬公司）至瀋陽市郊區之行動。福昇之業務為製造及銷售中密度板。

### 高科技相關業務

鑑於本集團已為其高科技相關業務建立穩固的基礎，故本集團已準備就緒，把握環球市場之機會，特別是系統整合晶片（「SoC」）解決方案與服務方面之商機。SoC為精密的集成電路（「集成電路」），於一片晶片中嵌入精密的系統及裝置，使製造商得以製造體積細小之產品及減低生產成本。SoC迅速成為資訊及電子業界之主要組件，包括無線、寬頻通訊及數碼消費電子業界。

本集團專注於技術項目之分支機構—福華先進微電子股份有限公司（「福華先進」）為一家無廠房SoC原設計製造商，為大中華地區半導體市場提供SoC和以SoC為本之解決方案。福華先進為客戶提供集成電路設計、以平台為本之SoC服務及重新確定目標服務。此外，福華先進亦協助主要品牌晶片公司增強產品功能，使有關客戶得以降低成本、減低地區風險及提高生產力。

於二零零五年，福華先進推出了EZL-8051 SoC設計平台——一個主要配合學校及設計公司需要的SoC服務解決方案。透過內部使用上述設計平台，福華先進開發了「Kernel SoC」及「應用平台」，讓客戶得以自行開發SoC晶片及解決方案。

隨著愈來愈多半導體製造商把廠房搬遷至亞洲地區，特別是中國，中國將於不久將來成為全球最大的半導體市場。為了抓緊市場上的未來商機，本集團於年內在上海設立了新的辦事處，並計劃於深圳設立另一新的辦事處。

此外，福華先進在台灣、中國、美國及日本等地均設有辦事處，這網絡有助福華先進贏取於潛在客戶群內的知名度。憑藉福華先進獨特的業務模式及其由矽谷及台灣集成電路專才組成之專業隊伍，福華先進當可進一步提升設計能力，拓展業務。

### 未來計劃及前景

展望未來，福邦將繼續改善整體營運效率，以及增撥更多資源至旗下錄得盈利之業務。關於木材業務，本集團將繼續物色及發展新的及現有的海外市場，拓展銷售渠道及擴大客戶基礎。

## 主席報告書 (續)

有見中國及台灣的半導體消耗量不斷急升，加上預期將有更多半導體工廠搬遷至亞洲地區，本集團預期SoC市場於未來數年將會持續增長。鑑於該等製造商尋求外判SoC生產業務，本集團當可在市場需求上升之大勢下受惠。福邦將會充份發揮其管理層之專業知識，並加強研發工作，爭取SoC市場之發展良機。預期高科技相關業務將會為本集團未來業績提供更多的貢獻。

於二零零六年，除了推廣EZL-8051平台外，本集團亦計劃推出全新原設計製造SoC及解決方案產品，以抓緊不斷增長的MP3及保安(軟件保護)市場。由於上述產品價格具競爭力，質素優異且功能超卓，故本集團對有關產品充滿信心。

### 致謝

本人謹此代表董事會向全體股東、董事、員工、客戶、供應商及業務夥伴致以深切謝意，感謝他們對本集團一直以來之鼎力支持。

承董事會命

主席

楊秉禾

香港，二零零六年四月二十一日